

3EC-III

- 於全球的標準銅箔，我們的3EC-III type銅箔，有著相當高的市佔率。
Global standard copper foil, we have high share in the worldwide market.
- 適中的黏著面(處理面)粗糙度，也適用於高密度的IC封裝載板等。
Middle profile in the laminate side, suitable for fine pattern circuit.

用途/Application

- IC封裝載板
/Semiconductor Package
- 高密度互連技術板
/High Density Interconnect
- 軟性電路板
/Flexible Print Board

構成/Composition



生產地點/Production Site

- 日本/Japan
- 台灣/Taiwan
- 馬來西亞/Malaysia

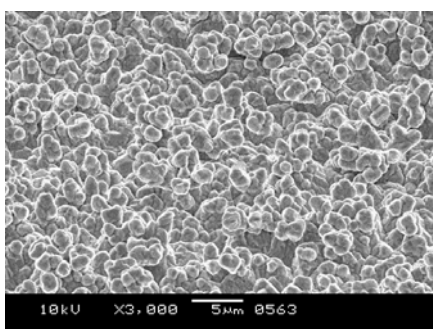
代表性特性數據/Representative

	μm	Area weight (g/m ²)	Laminate side Rz(μm)	Tensile Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	Peel Strength (kg/cm)@FR-4
3EC-III	12	107	4.5	370	5	1.2
	18	153	5.0	370	8	1.4
	35	285	7.0	370	15	1.9

※上述表列為代表性數據非保證值。

This is representative data, not guaranteed.

處理面/Laminate side



阻劑面/ resist side

